

# 安徽耐科装备科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：耐科装备

证券代码：688419

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流</u>
参与单位名称及人员姓名	华泰保兴基金 贾沛璋 博时基金 何坤 民生证券股份有限公司 周晓萌 海通证券 肖隽翀 张幸 国海机械 杜先康 广发证券 王宁 许贝尔
时间	2024年04月19日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄戎、董事会办公室职员：刘胡洁
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、简单介绍企业情况</b> 耐科装备主要业务为智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的装备及系统解决方案，主要产品为服务于半导体后道工序塑料封装工艺的封装设备及模具和服务于塑料异型材生产工艺流程中最关键的挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备。其中基板粉末封装设备开发取得初步完成，工程样机完成试制，处于测试阶段，争取早日完成进口替代。 半导体行业自22年开始进入下行周期，受到多方面因素影响，导致市场低迷，需求量减少，公司22年四季度起业绩开始逐渐呈下滑趋势，但公司挤出业务23年保持良好增长状态，同比增速接近40%。目前来看，

半导体相关业务开始回暖，挤出相关业务依然保持良好增长。

## **2、公司塑封机目前主要应用于哪些封装结构**

目前，塑封机主要成型工艺为转注成型和压塑成型两种方法，国内封装装备主要为转注成型的技术，压塑成型设备在国内依赖进口，转注成型可以用于 BGA、DFN、QFN 等产品不同形式的封装，部分也属于先进封装工艺。公司涉及压塑成型技术的晶圆级封装装备样机已完成试制。

## **3、先进封装塑封机进展，如晶圆级/2.5D/3D 塑封机产品进展、客户进展**

晶圆级封装装备研发是公司自行立项的研发项目之一，晶圆级封装装备自 20 年开始研发，样机已于今年在展会中展出，现处于样机试验阶段，很多数据还需要通过不断的反复试验来验证，预计 24 年底可进行销售。

## **4、公司塑封机单价，传统封装与先进封装的塑封机单价差异？**

半导体封装装备为定制化产品，产品结构不一样，技术参数不一样，制造加工周期、价格也不一样。根据客户需求生产，以 180T 一拖四标准化产品为例，设备单价大约在 450 万元左右，先进封装塑封机在国内还处于空白，据了解，国外晶圆级封装装备进口售价在人民币 1000 万元-1500 万元左右。

## **5、公司塑封机的产能**

公司设备偏定制化，没有标准的产能概念。以 180T 全自动封装设备为例，目前公司每年能提供约 30 多台(套)设备。

## **6、公司产品相比于其他同类公司的主要竞争优势**

公司产品都有自己专有技术，如专利技术等，在半导体封装装备领域，本公司拥有移动式预热平台，自动

	<p>润滑系统等自主研发技术。挤出成型装备以欧美高端市场为主。</p> <p><b>7、半导体业务 24 年一季度情况</b></p> <p>订单回暖明显，行情逐步向好。</p> <p><b>8、新厂建设进度</b></p> <p>4 月 20 号厂房将封顶，后期进行内部装修、设备安装等，预计 24 年底可以投产使用。</p> <p><b>9、在挤出业务方面，公司和奥地利 EXELLIQ 技术对比，技术是否超越对方</b></p> <p>公司技术虽未超越，基本处于同一水平，相较于国外厂家设备，本公司设备性价比高，具有竞争优势。</p> <p><b>10、挤出业务海外市场未来是否会降价</b></p> <p>随着生产成本上升，销售价格也处于增长趋势。</p> <p><b>11、24 年一季度挤出、半导体业务增长预期</b></p> <p>随着半导体市场行情回暖，相较 23 年一季度，公司业绩处于增长状态。</p> <p><b>12、主要出口国家和地区，欧美地区的去年收入占比</b></p> <p>公司挤出成型装备产品主要出口到欧美、俄罗斯等 40 多个国家和地区，其中欧美占比较大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 04 月 19 日